

## **有研半导体硅材料股份公司**

### **2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额和资金到账情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

##### **（二）募集资金使用和结余情况**

公司以前年度已累计使用募集资金398.77万元，本年度实际使用募集资金46,920.32万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为120,958.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额

为25,958.60万元，与募集资金余额相差95,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	784,407,766.66
减：本年度投入募集资金总额	469,203,190.29
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	6,383,273.13
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	65,175,700.00
减：支付的其他发行费用	15,416,358.37
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	31,356,719.11
募集资金专项账户期末余额	259,585,963.98

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京航天城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京东单支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构

中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	12,341.23	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	183.86	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	5,749.10	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.16	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	7,591.25	活期存款

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九

次会议，审议通过《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金10,214.00万元，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了审验，并于2023年3月28日出具《关于有研半导体硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2300402号），具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

截至2023年12月31日，公司对各项目先期投入进行置换，明细如下：

单位：人民币元

项目名称	截至2023年1月31日止 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	置换金额
集成电路用8英寸硅片扩产项目	57,511,327.42	57,511,327.42
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	35,824,527.50	35,824,527.50
发行费用	8,804,094.35	8,804,094.35
合计	102,139,949.27	102,139,949.27

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，2023年11月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集

资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币124,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	25,000.00	2023.11.16- 2024.02.19	否
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	50,000.00	2023.11.16- 2024.02.19	否
浦发银行北京分行	结构性存款	浮动收益	20,000.00	2023.11.17- 2024.02.18	否

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年03月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟用于永久补充流动资金的金额为19,500万元，占超募资金总额的比例为29.37%。具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

截至2023年12月31日，公司已将19,500万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023年1月20日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司山东有研半导体材料有限公司增资用于实施募投项目的议案》同意公司使用募集资金人民币 74,217.19万元向控股子公司山东有研半导体材料有限公司进行增资。具体内容详见公司于2023年1月31日刊登在上海证券交易所网站的《有研半导体硅材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2023-004）。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2023年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司上述专项报告在

所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对有研半导体硅材料股份公司募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2024)第1253号）。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：2023年度公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2023年度不存在募集资金投向变更的情况；具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。

#### **八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年3月29日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(注 1)				1,663,967,265.37		本年度投入募集资金总额				469,203,190.29		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				473,190,853.03		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	110,875,812.24	114,863,474.98	-142,964,625.02	44.55	不适用	不适用	不适用	否
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	108,862,468.24	108,862,468.24	-275,961,831.76	28.29	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	无	357,347,600.00	357,347,600.00	357,347,600.00	54,464,909.81	54,464,909.81	-302,882,690.19	15.24	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	274,203,190.29	278,190,853.03	-721,809,146.97	27.82	—	—	—	—
超募资金永久补流(注 2)	无	不适用	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,000,000,000.00	1,195,000,000.00	1,195,000,000.00	469,203,190.29	473,190,853.03	-721,809,146.97	39.60	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内,公司未发生此情况						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理情况						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						详见三、(八)募集资金使用的其他情况						

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日止，超募资金总额 663,967,265.37 元，其中 195,000,000.00 元用于永久补流。



注 3: 由于公司未承诺截至期末投入金额, 此处填写为募集资金承诺投资总额。